**专业培训记录**

**■QMS** **□50430**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | | 滁州市世丰电子有限公司 | | | | 专业小类/  项目代码 | | 19.01.02 |
| 教师姓名 | | 李俐 | | 专业 | 19.01.02 | 培训地点 | | 远程 |
| 受培训人员 | 姓名 | 周文廷 |  |  |  |  | |  |
| 生产工艺/  服务过程 | | PCB板上架→锡膏印刷→元件贴装→回流焊→LY检测→插件→波峰焊接→修板→通电测试→刷入程序→上机测试→交付 | | | | | | |
| 关键过程及需要确认的过程及主要控制参数 | | pcb线路板的工程资料评估、锡膏印刷、元件贴装、回流焊、LY检测、插件、波峰焊接、通电测试、刷入程序、上机测试  需确认过程：锡膏印刷、回流焊、波峰焊接、刷入程序 | | | | | | |
| 相关质量法律法规的要求及产品标准 | | GB/T 2900.66-2004 电工术语 半导体器件和集成电路  GB/T 15651.3-2003 半导体分立器件和集成电路 第5-3部分：光电子器件 测试方法  GB/T 17574.10-2003 半导体器件 集成电路 第2-10部分：数字集成电路 集成电路动态读/写存储器 空白详细规范  GB/T 19403.1-2003 半导体器件 集成电路 第11部分：第1篇：半导体集成电路 内部目检 （不包括混合电路）  GB/T16464-1999半导体器件集成电路  IEC 61190-1-3-2010 电子组件用连接材料 第1-3部分:电子焊接用电子级钎焊合金及有焊剂和无焊剂的固体焊料的要求 IEC 61249-8-8-1997 互联结构材料--第八部分: 非导电膜和涂层用装置的分规范--第八节: 临时聚合物涂层. | | | | | | |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) | | 通断测试，外观检验，功能检验，外形尺寸，孔径大小  无型式检验需求 | | | | | | |
| 其它相关知识 | | 无 | | | | | | |
| 填表人  (专业人员) | |  | | 日期 | | | 2022.3.15 | |
| 审核组长 | |  | | 日期 | | | 2022.3.15 | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**